037系列开发资料

前言：037系列芯片，包括单封和合封两类，合封又分双N合封和NP合封两类。

# 参考手册：037系列为同一内核，适用相同的参考手册。

最新版本为：LCM32F037\_RM\_20221107\_V7.3

# 说明书：037单封芯片一份说明书。

LCM32F037说明书\_20221213\_V3.6,适用于型号037H6S8,037K6U8,037K6T8

# 037合封芯片两份说明书

双N合封：LCP037B系列说明书\_20221213\_V1.2

PN合封：LCP037A系列说明书\_20221213\_V1.2

# 参考例程，037系列不管单封合封为同一份SDK

最新版本为 lcm32f037\_V1.1.4\_20230317

# 支持KEIL的pack包，点击安装即可，环境搭建参考<<领芯32位MCU环境搭建20220517>>

PACK包版本为：Keil.LCM32F0xx\_DFP.0.4.59

# 注意问题

## 6.1boot脚，037单封芯片出厂未烧死并不固定从mainflash启动，boot脚需接地，如果需要烧死启动方式，参考手册《领芯32位芯片如何固定从MainFlash启动》

## 6.2跑高频，037芯片跑高频，系统配置了LVR，低电压复位，需注意供电电压是否足够。

## 6.3烧录口复用，烧录口复用后，需使用烧录器复位，具体咨询我司技术支持人员。